



深圳市中顺半导体照明有限公司

—ShenzhenZhongshunSemiconductorLightingCo.,Ltd.—

SMD LED 产品使用说明

尊敬的客户：

为避免产品使用过程中因操作不当导致失效风险，现对我司 LED 灯珠产品使用做如下说明：

一. 储存

1. 未拆包前储存条件：温度 $<30^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<60\%RH$ 。客户使用前请核对标签上的日期，按照先进先出原则操作。
2. 3 个月内包装良好未漏气产品可以直接上线使用，拆包后必须在 4 小时以内完成贴片作业；贴完片后需 2 小时内过回流焊，SMT 环境湿度要求 $<60\%RH$ ；建议客户在每包使用至剩 1/3 以下时再拆下一包，减少材料暴露在空气中的时间
3. 超过 3 个月材料和包装袋漏气或破裂、拆包后未在规定时间内使用完的产品在过回流焊前需重新进行除湿作业：编带产品除湿条件： $70^{\circ}\text{C}/12$ 小时。除湿好后关闭烤箱，陆续取出材料，确保 4 小时内用完，或可将烤箱 70°C 保温至材料使用完毕。

二. 焊接

建议客户检查高温回流焊是否存在温度设置过高、或温区“设置温度”差异过大或运送链速过快等现象。

1. 产品焊接最高温度 $<240^{\circ}\text{C}$ ，高温时间 $<10\text{s}$
- 2 产品过回流焊的次数 <2 次。
- 3 灯珠焊接过程中表面不能施加任何压力；焊接完成后要等产品温度下降到室温后再进行其它操作。
4. 焊接完成后，如有异常灯板需维修时，建议加热台温度控制在 250°C 以内，避免给灯珠加热温度过高，减少维修时对其它灯珠造成的影响。

